证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-056

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/11/6，由董事长蔡国智先生提议
回购方案实施期限	2026 年 11 月 6 日~2027 年 11 月 5 日
预计回购金额	5亿元~8亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	352,400股
累计已回购股数占总股本比例	0.02%
累计已回购金额	10,039,067.97元
实际回购价格区间	28.05元/股~28.62元/股

一、 回购股份的基本情况

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份将在未来适宜时机用于 A 股员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 8 亿元（含）。回购价格不超过人民币 37.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购 A 股股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书》（2026-049）。

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：

2026 年 11 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 352,400 股，占公司总股本 2,234,787,210 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 28.62 元/股，最低价为 28.05 元/股，支付的资金总额为人民币 10,039,067.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、 其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日